

本製品のはんだ付け実装における注意事項

本製品は表面実装型パッケージ(SMD)です。

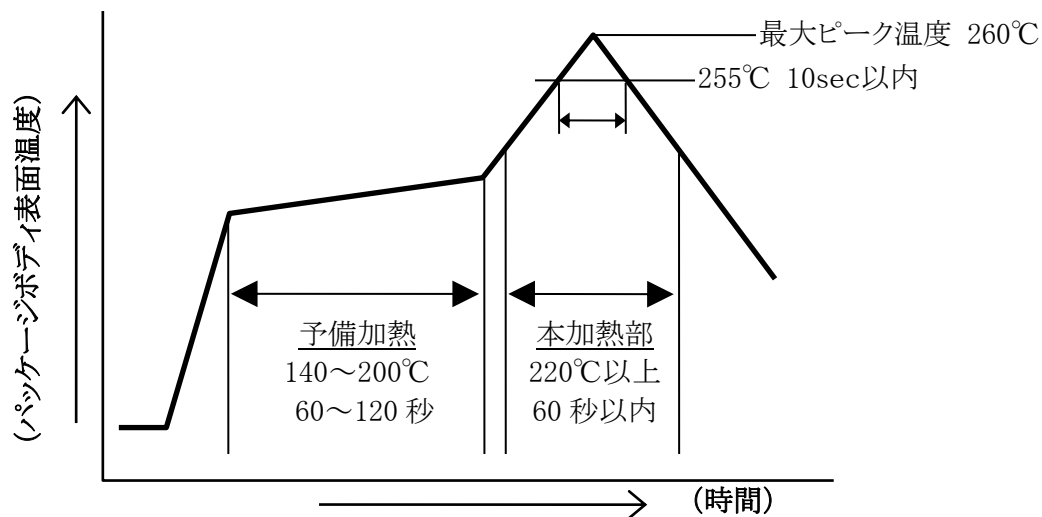
はんだ付け時のストレスに対するICパッケージの耐熱性は、製品の保管条件(環境)及び、はんだ付け方式・条件によって影響されます。

従いまして本製品に関しては、次に示すはんだ付け推奨条件の範囲内にてご使用されることをお願い申し上げます。

実装前保管条件

	保管条件	期間
防湿梱包開封前	30℃85%RH 以下	1 年間
防湿梱包開封後	30℃70%RH 以下	3 日間(72 時間)

許容温度プロファイル条件



本製品は赤外線/温風/赤外線・温風併用リフロー方式によって実装してください。

リフロー回数は2回までとし、上記保管時間内に実施してください。

酸化の影響を抑制し、また濡れ性を改善するために、窒素雰囲気リフローをお奨めします。

※手はんだ付けを実施する場合は、はんだごてがパッケージのリード部以外に接触しないように注意してください。

＜条件＞ こて先温度:350℃以下、時間:5秒以内、回数:2回以下

推奨乾燥条件

梱包(防湿袋)開封後の許容保管期間を超えた場合は、実装前に下記条件にて乾燥処理を実施してください。

温度	時間	回数
125±5℃	20~36 時間	2 回以内

ベーキング実施後から実装までの保管条件は、上記保管条件と同一です。

※出荷形態がテープ&リールの場合、耐熱性のトレイ等に移して乾燥処理を実施してください。

(保管ランク: MSL4)